

## 2021년도 과학기술정보통신부 Si반도체 실증지원사업 신규지원 대상과제 공고

과학기술정보통신부와 정보통신산업진흥원은 AI반도체가 미래산업의 기회요인인 만큼 AI 반도체 원천기술 조기 확보, 관련 기술 확산 등을 위해 기술 실증 지원 사업을 공모하오니 많은 참여 바랍니다.

2021년 2월 22일

과학기술정보통신부장관

정보통신산업진흥원장

### 1. 사업 개요

- 인공지능(AI)·데이터 생태계의 핵심기반인 AI 반도체 산업 육성을 위해 국내 기술로 개발한 AI 반도체의 활용·확산을 위한 기술 실증 지원

### 2. 지원 대상

- AI 응용서비스, AI반도체 기술 보유\* 기업, 연구소 등(컨소시엄 가능)
    - 주관·참여기관에는 AI반도체 기술을 보유\*한 기관 및 AI응용서비스를 보유(신규 개발 계획 포함)한 기관이 포함되어 있어야 함
- \* 국내 기술로 Si반도체를 ASIC 등 상용화 수준으로 개발 중이거나 개발 완료한 실적을 제시하고 관련 증빙 서류를 제출할 수 있는 수준

### 3. 사업 내용

#### ○ (사업규모)

구 분	주요내용
지원 과제 수	○ 2개 과제
지원 규모	○ 총 2,200백만원(과제별 최대 1,100백만원)

\* 지원규모는 사업비 심의위원회 심의 결과에 따라 조정될 수 있음

#### ○ (사업기간) 2년

- 1차년도 : 협약체결일('21. 4. 예정) ~ '21. 12. 31(9개월)

- 2차년도 : 협약체결일('22. 1. 예정) ~ '22. 11. 30(11개월)

\* 1차년도 과제 선정 후 연차평가 결과에 따라 2차년도 '계속' 지원(60점이상) 여부를 결정하며, 연차평가 결과 지원 '중단'의 경우 2차년도 지원 불가함

#### ○ (사업내용) AI 반도체·보드 제작 및 시제품 서버 구축, 실증 등 관련 사업비

구 분	주요 지원 내용
시제품 서버 구축 지원	○ AI 반도체 칩 및 보드 제작, 시제품 서버 구축
서버 시스템 검증 지원	○ 응용 서비스 실증용 서버 시스템 HW·SW 검증
응용서비스 실증 지원	○ 서버 실증 환경 구축, 응용 서비스 실증

#### ○ (민간매칭) 사업에 참여하는 기관(컨소시엄 가능)은 총사업비 중 정부지원금을 제외한 비용에 대해 민간매칭(현금·현물)을 하여야 함

### 4. 접수기간 및 방법

#### ○ 공고기간 : '21. 2. 22(월) ~ '21. 3. 24(수)

\* 정보통신산업진흥원 홈페이지([www.nipa.kr](http://www.nipa.kr)) 알림마당 사업공고 참조

#### ○ 접수마감 : '21. 3. 24.(수), 16:00 까지

\* 전산 접수 마감 시간 이후에는 전산접수 자체가 원천적으로 불가하며, 신청자가 전산 접수 마감 시간 이전 접속하였으나 마감 시간 경과로 제출을 완료하지 못한 경우는 미제출로 사전 제외함

#### ○ 접수방법 : 전산접수

\* 정보통신산업진흥원([www.nipa.kr](http://www.nipa.kr)) 홈페이지 하단(LinkZone) → 사업관리시스

템(SMART, <https://smart.nipa.kr>) → 총괄책임자 회원가입 및 로그인 → 전산 접수 → 제출완료

○ 제출서류 : 사업계획(신청)서 및 관련 서류([www.nipa.kr](http://www.nipa.kr) 사업공고 참조)

## 5. 사업설명회 개최

구분	내용
일시	2021. 2. 24(수), 16:00~17:00
장소	경기도 성남시 수정구 대왕판교로 815, 기업지원허브 ICT문화융합센터 3층, 첨단공연장
신청방법	이메일 신청(tkpark@nipa.kr)

## 6. 관련규정

○ 「정보통신방송사업 관리규정」, 「정보통신방송사업 사업비산정 및 정산 등에 관한 기준」, 「정보통신방송사업 평가 및 성과관리 기준」, 「NIPA 지원사업관리요령」 등

## 7. 문의처

구분	담당자	연락처
사업관련 문의	ICT산업전략팀 박태근 수석	043-931-5045 (tkpark@nipa.kr)
접수시스템 관련 문의	정보통신산업진흥원 스마트시스템 유지보수팀	070-5151-8239

